

大阪大学 新技術説明会

参加無料
事前申込制

【日時】 2020年2月4日(火) 11:00～15:25 (開場10:30)

【会場】 JST東京本部別館1Fホール (東京・市ヶ谷)

【主催】 科学技術振興機構、大阪大学

【後援】 特許庁、関東経済産業局、テックマネッジ株式会社

11:00～11:25	① 深層学習による超高速な画像超解像化方法
情報	産業科学研究所 知能推論研究分野 助教/原 聡
11:30～11:55	② MHP1ペプチドによる炎症性/免疫疾患治療
創薬	医学系研究科 健康発達医学講座 寄附講座准教授/島村 宗尚
11:55～13:00	昼休憩
13:00～13:25	③ バイオ医薬品のためのタンパク質N末端選択的修飾技術
創薬	工学研究科 応用化学専攻 准教授/小野田 晃
13:30～13:55	④ 感触を損なわずに弾性柔軟素材を触覚センサにする技術
計測	工学研究科 知能・機能創成工学専攻 講師/石原 尚
14:00～14:25	⑤ Ag焼結接合による異種材接合によるパワーモジュール構造の新展開
デバイス・装置	産業科学研究所 先端実装材料研究分野 特任助教/陳 伝トウ
14:30～14:55	⑥ 軽量ウェアラブルデバイスのための新センシングフレームワーク
計測	工学研究科 電気電子情報工学専攻 講師/兼本 大輔
15:00～15:25	⑦ パワーモジュールの熱性能・信頼性評価に必要な過渡熱抵抗評価方法
デバイス・装置	工学研究科 電気電子情報工学専攻 教授/舟木 剛

シーズ概要・参加申込・個別相談申込は、
こちらのWebサイトから

https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/osaka-u/2019_osaka-u.html



お問い合わせ

大阪大学共創機構 産学共創・渉外本部
イノベーション戦略部門 産学官連携支援室
TEL : 06-6879-4875
E-mail : contact@uic.osaka-u.ac.jp
URL : <https://www.uic.osaka-u.ac.jp/>